证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> ☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议） </p>	
<p>参与单位及人员</p>	<p> 李浩-国开泰富基金 边悠-明亚基金 梁忻-东方基金 阮文俊-太平资产 史文琪-华泰证券 陆从珍-华泰柏瑞基金 黄进-生命保险资产 黄磊-中信建投 王亦琛-东海基金 石础-北信瑞丰基金 杜超宇-中金基金 蔡锐帆-天弘基金 陈旭-兴业基金 朱战宇-中邮人寿 巩象亮-泰信基金 钱栋彪-泰信基金 郭百华-华融证券 黄晓-富道投资 王悦君-兴业证券 </p>	<p> 王佩麟-兴业证券 李双亮-兴业证券 邱泓瑞-群益证券 黄磊-中信建投 周阳-华安基金 冯杰波-上海域秀资管 茅珈凯-上海从容资管 孟庆峰-上海磐厚资管 赵炯-恒越基金 傅鑫-中泰证券 孙卫党-融通基金 黄晓-富道资管 何琦-华泰柏瑞 孙小明-诺德资管 王磊-雷根资管 徐帆-上银基金 焦庭恺-望正资产 张思颜-南方天辰投资 魏晓雪-光大保德信基金 </p>
<p>时间</p>	<p>2022年06月</p>	
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>	

接待人员	董事长潘连胜博士、董事会秘书袁欣女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司三大主营业务情况</p> <p>大直径硅材料：</p> <p>目前公司大直径硅材料产品生产情况稳定，产能按计划扩充中。一方面，公司结合客户的订单预期以及行业未来几年的发展需求，着手进行生产厂房的基础建设工作；另一方面，通过工艺改进和设备升级等多方面手段来增加既有生产设备的单炉次产量，有效地控制成本。公司发挥特有的晶体生长技术优势，确保产品品质上的稳定性，一致性，保持国际上的领先地位；多晶质产品方面，在稳定工艺窗口的基础上，根据客户评估进度以及订单预期，小批量生产中。</p> <p>硅零部件：</p> <p>公司硅零部件产品主要面向中国国内市场进行销售拓展。在为刻蚀设备厂家配套方面，公司继续加强与国内等离子刻蚀机设备制造厂商——中微公司和北方华创的合作，共同开发适配于不同机型的多种硅零部件产品；同时，公司接受国内集成电路制造厂商定制化委托，根据客户需求配合其设计开发不同型号的硅零部件，已获得国内多家12英寸集成电路制造厂的送样评估机会，取得了小批量定制化订单。</p> <p>在国内12英寸集成电路制造厂商定制化需求的快速增长带动下，公司的硅零部件产品将获得更多国内客户的评估认证机会，并形成稳定的批量订单。为保证客户订单的及时交付，公司会扩大生产规模，做好设备采购、安装调试等前期准备工作，确保年内可以实现较快速度的产能爬升。</p> <p>半导体大尺寸硅片（8英寸轻掺低缺陷硅抛光片）：</p> <p>公司的8英寸测试硅片已经通过了某些国内客户的评估认证；同时，8英寸轻掺低缺陷超高阻硅片，正在客户端评估中，进展顺利；另外，公司完成了与国内主流客户在技术难度较高的8英寸硅片上的规格对接工作，并启动了后续的评估送样工作。</p> <p>公司将确保更高产量条件下的高良率水平；随着已订购设备的陆续进场，安装调试等工作的进行，公司大尺寸硅片产能将继续稳健扩充。</p> <p>公司将根据下游客户的技术要求，深化低缺陷路线下的高技术含量产品的研</p>

发及批量生产工作，如轻掺高阻硅片、超平坦硅片、氩气退火片等，争取年内获得国内主流集成电路制造厂认证通过并形成小批量订单；公司将继续探索并积累12英寸半导体级低缺陷晶体的生长工艺。

二、公司业绩与产业链下游的传导关系

大直径硅材料是公司主营产品之一，是下游硅零部件制造商硅电极产品的直接原材料，半导体设备制造厂商购买硅电极产品，与新设备配套出货（增量市场）；或供应终端用户即集成电路制造厂商，投入产线中正在运行的设备中（存量市场）。

目前，全球各国竞相扩张本土集成电路制造产能，半导体制造设备供不应求，设备制造厂商遭遇供应瓶颈，出现因缺少部分材料或零部件而导致的整部设备延迟交付。这一情况在一定程度上影响到公司大直径硅材料产品的增量市场。

根据公开信息，Lam Research于2022年4月表示，订单总量和未完成订单量已创下历史新高，2022年第一季度末递延收入达20亿美元；AMAT于2022年5月表示，当前公司在手订单已排至2024年，积压订单产品数量超过两个季度的产能。

因此，尽管公司具备按时交付能力且下游需求旺盛，但仍有可能因下游设备及零部件制造厂商的交付调整递延，造成公司一部分大直径硅材料产品的“被动交期调整”。

被动交期调整会体现到公司在个别月份或个别季度间的业绩变化，但公司的下游需求仍然旺盛且在手订单并未减少。因此，根据以上最新产业动态，当前宜采用更长的时间周期来观察公司的业绩表现。

三、硅零部件产品的研发过程

硅零部件的研发过程可以概括为“定制化”：集成电路制造厂商根据其既有机台的使用特点，向公司提出技术改进要求，公司配合集成电路制造厂商共同进行产品改进，以达到客户更佳的使用体验。

四、国内疫情对公司生产经营的影响

公司生产基地所在地辽宁省锦州市和福建省泉州市基本没有本土疫情发生，国内疫情并未对公司生产造成直接影响。

公司主营产品大直径硅材料主要面向海外客户销售。海外市场需求旺盛，出货港口大连港运营情况良好，因此公司主营产品销售未受国内疫情的影响。

公司半导体大尺寸硅片产品仍处于产能爬升阶段，该产品所需的厂务配套物料、包装材料、特种气体部分供应自上海及其周边地区，因此在第二季度的部分特定时段受到影响；同时，公司大尺寸硅片某些目标客户位于上海地区，这些客户的产品送样评估活动受到疫情影响有所延迟，但公司采用增加线上交流等方法减小此类影响。

五、公司如何应对多晶硅原料价格上涨

2022年第二季度，多晶硅原料市场价格受到包括国内疫情、光伏级多晶硅需求持续增长等多种因素影响，继续上涨。大直径硅材料的产品品质直接影响终端用户集成电路制造厂商的生产良率，关乎终端用户的产线品质水平。公司作为全球细分市场领先企业，一贯严格选择海外主流大厂生产的高品质多晶硅原料，以确保产品高质量交付。

为应对多晶硅原料价格上涨造成的成本压力，公司采取了多方面措施：第一，拓展进货渠道，确保稳定供应；第二，主动调整产品结构，产能向高毛利产品倾斜；第三，按既定计划扩充产线以摊薄固定成本和采购相关费用；第四，积极改进生产设备并优化生产工艺，提高良率，以抵消原料价格上涨影响；第五，秉承共存共荣理念，及时向下游客户传递多晶硅原料市场价格信息，根据客户需求、技术规格、产品类型进行针对性价格调整。

附件清单	无
日期	2022年6月